

地域	大阪府大阪市	認定日	平成24年2月3日	5-23-157
事業分類	製造(その他の製造業)	テーマ分類	次世代	

**事業名: 次世代LSI用超薄型PCD(焼結ダイヤモンド)ダイシングブレード
製造販売事業**

○事業概要(新規性、市場性等)

- ・スマートフォンなど高性能・小型・薄型の電子機器に搭載される次世代LSI等では、素子が形成される基板(ウエハ)の薄型化が進んでいる。薄型化されたウエハから個別素子の切り離しを行うダイシング工程において、ウエハ自体のフレ、ダイシング面からのチッピング、クラック等の発生を極小化できるPCDダイシングブレードの開発・製造・販売を行う。
- ・ブレード全体が焼結ダイヤモンドと超合金で構成される素材を適用することにより、1)超薄型ウエハ(50 μ m以下)の高品位なダイシングを可能にする。加えて、2)既存ダイシング設備にも適用可能で、3)セミドライダイシング加工も実現する。

事業推進体制

PCD加工技術指導

渡邊純二
(熊本大学客員教授)

技術協力・販売

㈱東京精密

技術指導

大阪府立産業技術
総合研究所

連携体の構成

事業統括・開発・製造

コア企業:㈱新日本テック
(大阪府大阪市)

- ・事業統括
- ・PCDダイシングブレードの開発・製造
- ・PCDダイシングブレードの製造技術

材料調達

共栄研磨材㈱
(大阪府寝屋川市)
・PCD素材の調達

支援予定メニュー

- ①補助金
- ②低利融資
- ③特許料減免

技術指導

一般社団法人
ネオマテリアル
創成研究会

技術指導

財団法人
大阪科学技術
センター

技術指導

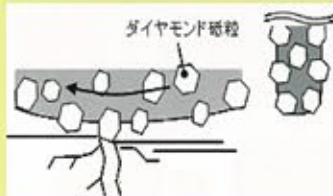
国立大学法人
熊本大学

技術指導

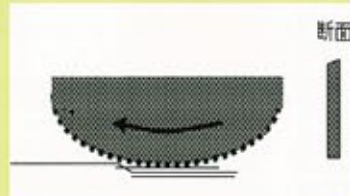
国立大学法人
大阪大学
接合科学研究所

ダイシングブレードの刃先構成

<従来ブレード>



<PCDブレード>



PCDダイシングブレード

